

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	（以下排名不分先后） 广发证券、国海证券、易米基金、长江证券、民生证券、东吴证券、国泰君安、SECF、东方财富、中信建投、中信证券、中信资管、中泰证券、中金公司、中银国际证券、光大证券、华夏未来、华安证券、华泰证券、国信证券、国联安基金、国金证券、天风证券、安信证券、工银瑞信、开源证券、敦和资管、浙商证券、海通证券、源来资本、西部证券、财信证券、远海私募、金信基金、鑫翰资本、银河证券、长城证券、阳光资产、高竹基金等多家机构。
时间	2024年4月25日 20:00
地点	深圳市曼恩斯特科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭亚林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司董事会秘书彭亚林先生简要介绍了公司基本情况、2023年度及2024年一季度的经营情况，2023年，公司实现营业收入79,503.51万元，同比增长62.76%，实现归属于上市公司股东的净利润34,137.41万元，同比增长67.98%；2024年一季度，公司实现营业收入18,315.02万元，同比增长21.47%，实现归属于上市公司股东的净利润5,735.26万元，同比下滑14.73%。</p> <p>2、请问一季度的收入结构及毛利率情况？ 答：今年一季度公司营业收入维持增长趋势，储能业务占比约15%，但由于子公司的储能业务正处于前期拓展阶段，规模效应尚未充分体现，一季度出现阶段性亏损，且智能装备产品相比去年同期亦有一定比例的增长，导致公司一季度的综合毛利率出现下滑，归属于上市公司股东的净利润也同比下降了14.73%。从核心部件的角度看，公司收入仍以基础款的涂布模头为主，但智能款、大容量等产品的收入占比有所提升，以高阶产品助力下游客户降本增效的策略逐渐显著，未来升级迭代的空间较大。</p>

3、2023 年度公司合作客户的结构变化？

答：2023 年公司前五大客户合计销售金额 5.69 亿元，占年度销售总额比例 71.52%，相比 2022 年减少了 12.20%。2023 年，凭借国际先进的涂布技术及持续迭代能力，通过强劲的产品力，公司新拓客户持续增加，新增客户数量同比超过 40%，进一步降低了客户集中度过高带来的经营风险。

4、公司涂布模头业务在建产能情况？

答：公司涂布模头的在建产能主要为了匹配新型材料涂布模头的产业应用以及泛半导体领域平板涂布系统产品的扩张需求，计划将于今年逐步释放产能。其中泛半导体领域主要涉及两米以上的超长幅宽模头，主要应用于面板显示、钙钛矿 GW 级涂布装备；而新型材料涂布模头主要指全陶瓷化涂布模头，具备高强度、高耐磨、耐腐蚀等优质特征，可以解决金属异物混入浆料的核心难题，进一步提升锂电池性能，除锂电领域外，该材料还可以很好适用于酸性或碱性的涂布溶液环境，应用场景广阔。

5、公司产品在固态电池领域的应用情况？

答：从产业技术发展来看，半固态电池比全固态电池的商业化进程更快。在湿法工艺方面，半固态电池对现有液态锂电池的材料体系有着较好的兼容性，传统湿法工艺同样适用于半固态电池生产，公司全新自研的全陶瓷化涂布模头凭借耐腐蚀、高耐磨等特性可以更好适配硫化物的固态电解质涂布。在干法工艺方面，公司亦有相应的技术储备，并已发布干法复合制膜一体机的新产品，可简化极片的制备工艺，减少生产的环境污染，降低电池的制造成本，安全性及能量密度均可以进一步提升。

6、泛半导体领域的进展？

答：基于涂布技术的平台化特征及工艺引领装备的成熟机制，公司在泛半导体领域已形成较为成熟的技术储备，可以满足客户对不同量级涂层工艺制程的差异化要求。2023 年，公司与中国科学院深圳先进技术研究院共同组建的钙钛矿薄膜太阳能电池联合实验室正式揭牌成立，该实验室是钙钛矿光伏器件机理探索和钙钛矿电池制程工艺研究的重要平台。该领域，公司已具备大尺寸钙钛矿产业化“配方-工艺-设备”协同研究的开发能力，完成了大面积溶液薄膜均匀涂布及结晶一体化布局，产品涵盖 GW 级、中试线及实验线等，其中中试线及实验线装备已获得多笔订单且部分已完成交付。在面板显示领域，公司亦顺利签约了头部显示面板企业的涂布模头订单。未来，公司将持续加大对平板涂布技术的研发投入，积极筹建中试平台，同时保持与下游应用企业、科研院校的紧密交流，以核心部件为切入点，积极推进公司智能装备在泛半导体领域的迭代发展及规模化应用。

	接待过程中，公司接待人员严格按照相关制度规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，参会投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月25日